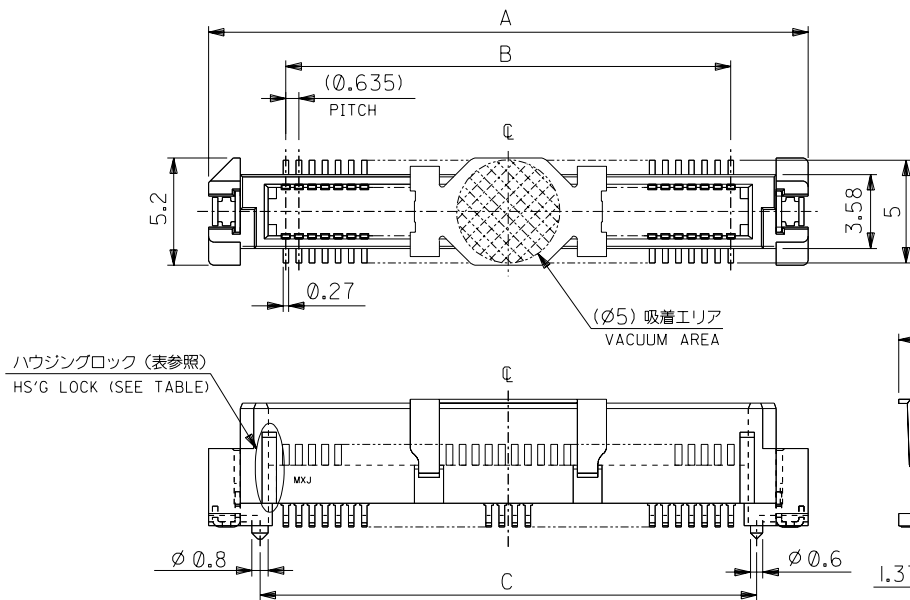
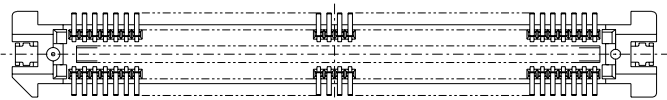




ハウジングロック (表参照)
HS'G LOCK (SEE TABLE)



注) NOTES

1. 材質 MATERIAL

ハウジング: ガラス入りPPS、茶色、UL94V-0
HOUSING: G.F. PPS, BROWN, UL94V-0
ターミナル: 銅合金 (t=0.2)
TERMINAL: COPPER ALLOY
補強金具: 銅合金 (t=0.25)
FITTING NAIL: COPPER ALLOY
吸着カバー: ステンレス (t=0.2)
VACUUM COVER: STAINLESS STEEL

2. メッキ仕様 PLATING

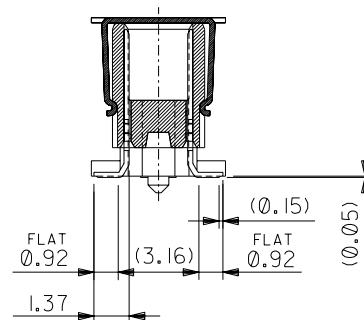
ターミナル: 接点部: 金メッキ 0.25μmMIN.
TERMINAL: CONTACT AREA: GOLD 0.25 MICROMETER MIN.
半田付け部: 錫メッキ 1.0μmMIN.
SOLDER TAIL AREA: TIN 1.0 MICROMETER MIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5μmMIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 1.5 MICROMETER MIN.
補強金具: 錫メッキ 1.0μmMIN.
FITTING NAIL: TIN 1.0 MICROMETER MIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0μmMIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 1.0 MICROMETER MIN.

3. テールのバラツキ寸法 TAIL COPLANARITY

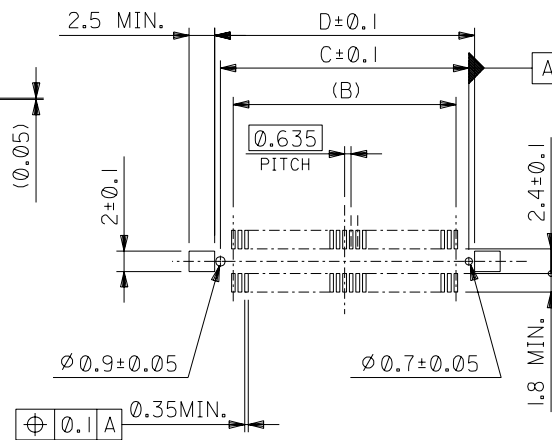
テール平坦度は、0.1MAX.とする。
TAILS COPLANARITY TO BE 0.1MAX.

4. エンボス対応済みの極数については、SD-53625-003を参照下さい。 FOR THE EMBOSSED PACKAGE PRODUCTS, SEE SD-53625-003.

5. 本製品は53625-***2の鉛フリー品である。 THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53625-***2.



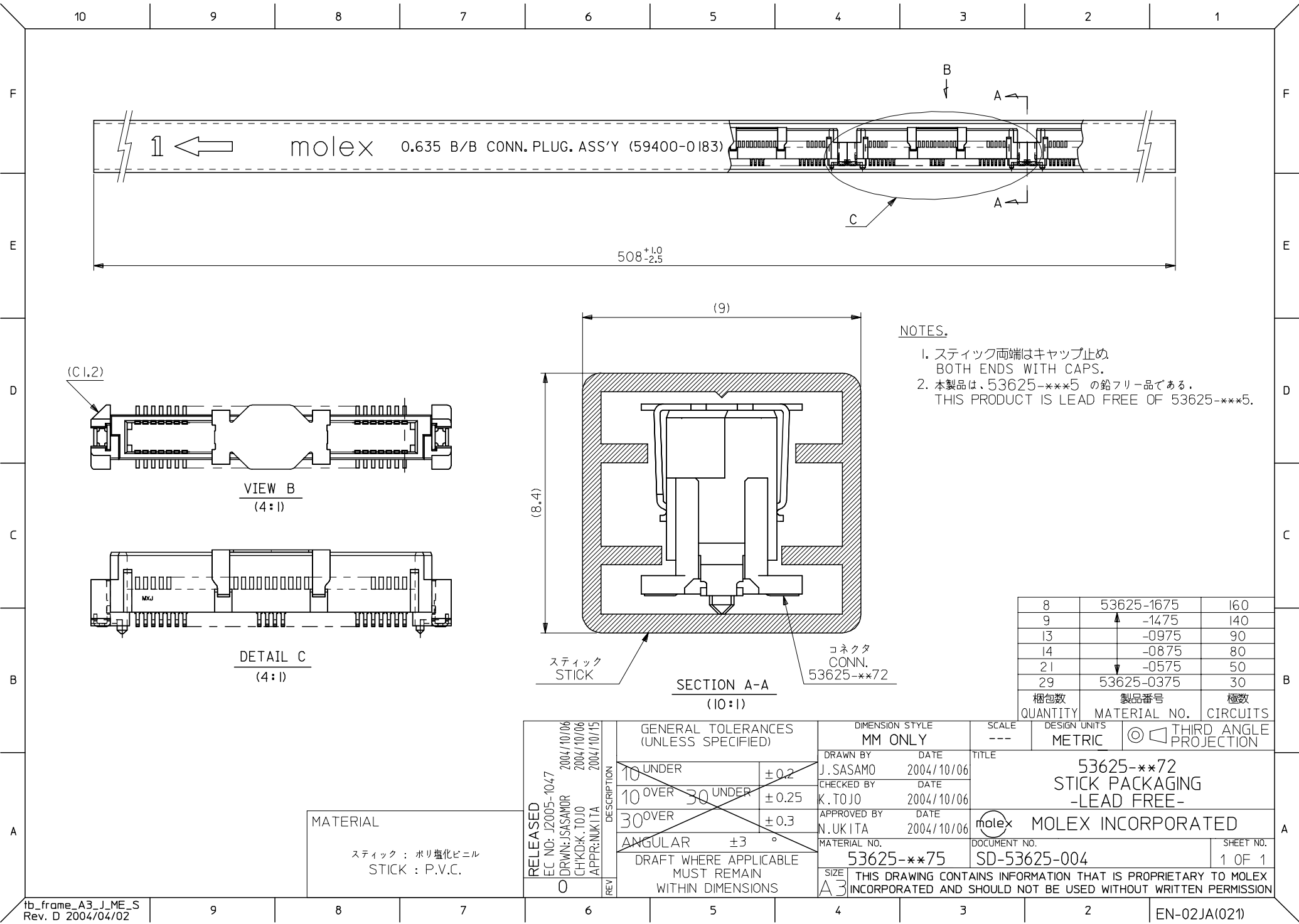
半田付け部詳細図
DETAIL FOR SOLDERING AREA



推奨基板寸法
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT
(SCALE: 2-1)

無し NO	79.17	78.07	75.565	83.07	53625-2474	53625-2472	240	○
	66.47	65.37	62.865	70.37	—	-2072	200	—
	60.12	59.02	56.515	64.02	—	-1872	180	—
	53.77	52.67	50.165	57.67	53625-1674	-1672	160	○
	47.42	46.32	43.815	51.32	—	-1472	140	○
	41.07	39.97	37.465	44.97	—	-1274	120	○
	34.72	33.62	31.115	38.62	—	-1074	100	—
	31.55	30.45	27.94	35.45	—	-0974	90	○
	28.37	27.27	24.765	32.27	—	-0874	80	○
	25.2	24.1	21.59	29.1	—	-0774	70	—
有り YES	24.56	23.46	20.955	28.46	—	-6874	68	—
	22.02	20.92	18.415	25.92	—	-0674	60	—
	18.85	17.75	15.24	22.75	—	-0574	50	○
	15.67	14.57	12.065	19.57	—	-0474	40	○
	12.5	11.4	8.89	16.4	—	-0374	30	○
	9.32	8.22	5.715	13.22	53625-0274	53625-0272	20	—
					エンボス梱包 EMBOSSED PACKAGING	製品番号 MATERIAL NO.	極数 CKT. NO.	量産対応 AVAILABLE
						MODEL NO.	53625-***72	
ハウジング HS'G LOCK	D	C	B	A				

				材料 MATERIAL		注) 参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH		注) 参照 SEE NOTES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				適用電線範囲 WIRE RANGE		—		TITLE 名称	
				被覆外径 INS. RANGE		—		0.635 PITCH B-TO-B CONN. PLUG HS'G COVER ASS'Y -LEAD FREE-	
				DRAWN BY '04/05/14 Y.WADA		CHK'D BY '04/05/14 M.SASAO		DWG. NO.	
				APP'D BY '04/05/14 M.SASAO		尺 SCALE		4-1	
				記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		REV	
				DR.		日付 DATE		0	
				一般公差 GENERAL TOLERANCES		0 新規作成 RELEASED (J2004-4233)		SD-53625-002	



molex 0.635 B/B CONN. PLUG. ASS'Y (59400-0183)

508^{+1.0}_{-2.5}

VIEW B
(4:1)

DETAIL C
(4:1)

SECTION A-A
(10:1)

NOTES.

- 1. スティック両端はキャップ止め
BOTH ENDS WITH CAPS.
- 2. 本製品は、53625-***5 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53625-***5.

8	53625-1675	160
9	-1475	140
13	-0975	90
14	-0875	80
21	-0575	50
29	53625-0375	30
梱包数	製品番号	極数
QUANTITY	MATERIAL NO.	CIRCUITS

RELEASED EC NO: J2005-1047 DRWN: J.SASAMO CHKD: K. TOJO APPR: NUKITA O	DESCRIPTION 2004/10/06 2004/10/06 2004/10/15	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION			
		10 UNDER		±0.2		DRAWN BY J. SASAMO		DATE 2004/10/06			
		10 OVER 30 UNDER		±0.25		CHECKED BY K. TOJO		DATE 2004/10/06			
		30 OVER		±0.3		APPROVED BY N. UKITA		DATE 2004/10/06			
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO. 53625-**75		DOCUMENT NO. SD-53625-004		SHEET NO. 1 OF 1			
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					
		REV									

MATERIAL
スティック : ポリ塩化ビニル
STICK : P.V.C.